

当前位置: 首页>>会展信息

## 2009全国电子电镀及表面处理学术交流会征文通知

2008-10-22

站内信息搜索:

搜索

--搜索引擎--

推荐企业

一. 为促进电子电镀行业可持续发展, 交流国内外先进技术和经验, 提高我国电子电镀表面处理技术水平, 经中国电子学会生产技术学会电镀专家委员会与上海电子学会电子电镀专业委员会讨论商定, 于2009年11月在上海联合召开全国电子电镀及表面处理学术交流会。

本次学术交流会将组织学术报告、技术交流、评选优秀论文等活动, 同时还将编印出版论文集, 现开始征集论文, 有关征集工作事项如下:

### 二. 征文内容:

1. 电子电镀技术发展方向论述。
2. 电子电镀方面新工艺、新技术、新材料的研究应用与推广, 如IC芯片电镀、MEMS电镀、PCB电镀、电子接插件电镀、脉冲电镀、高速电镀、激光镀、纳米电镀、电子元器件电镀等。
3. 轻金属电镀(铝及铝合金、镁及镁合金)、塑料电镀、汽车电镀及其他功能性电镀。
4. 常规电镀、化学镀及表面处理新技术, 质量控制和检测技术。
5. 环保技术、清洁生产技术的推广应用等。
6. 企业管理、技术质量管理的经验体会等方面文章。
7. 涂装工艺技术及其他工艺。

### 三. 论文要求:

1. 文字简单, 内容新颖, 指导性 or 实用性强, 未在国内外公开发行的刊物上发表过。
2. 论文全文不超过5000字, 征文前附英文标题、摘要及关键词。
3. 手工绘制的插图要求线条清晰, 为了辨认, 不可用铅笔或彩色笔绘制(建议用黑色笔绘制), 照片图采用清晰度高的黑白照片。
4. 文稿应注明作者姓名、职务、职称、工作单位、通讯地址、邮政编码、Email地址、联系电话。

### 四. 提交形式:

1. 论文以书面或电子版两种形式提交, 书面提交时需要A4纸打印后, 邮寄方式提交。
2. 论文请自行保留底稿, 提交的论文不论录用与否一律不退。

### 五. 征文截止时间

论文征集截止时间: 2009年7月31日

### 六. 论文寄送:

1. 电子版本可通过电子邮件投递  
电子邮件投递邮箱: dzddzwh@gmail.com

2. 书面稿或光盘稿投递地址:

邮编: 200433

电话/传真: 65643974

收件人: 孙玉玉

有关年会进一步信息可访问专委会网站: [www.e-plating.com](http://www.e-plating.com)

欢迎科研院所、高等院校、企事业单位从事电子电镀表面处理工作的科技人员踊跃投稿。

中国电子学会生产技术学会电镀专家委员会

上海市电子学会电子电镀专业委员会

2008年10月

**免责声明:** 中国表面工程信息网仅以现有的、按其现状提供有关的信息、材料及运行。我们不对有关本网站或其所提供的材料和信息的可用性、准确性或可靠性作出任何种类的保证, 包括但不限于对产权, 风险, 不侵权, 准确性, 可靠性, 适销性, 使用正确性, 适合特定用途或其它适当性, 或是连续不间断或无误差使用本网站的任何保证、陈述和担保。如果您发现我们的网站的任何材料或信息存在任何错误或误差或侵权, 请通过电子邮件(abc430030@126.com)将该错误、误差或侵权及时通知我们, 我们将万分感激并会即时予以改正。

